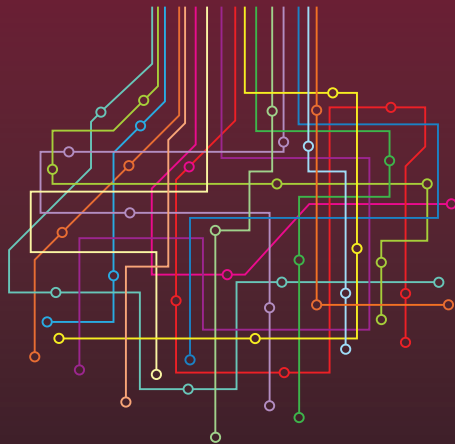




## Call for Tutorials

Nürnberg, 16. – 18.04.2013  
smt-exhibition.com

### The place to be!



## Komitee SMT 2013

### Komiteevorsitz

**Prof. Dr. Klaus-Dieter Lang,**

Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration,  
Technische Universität Berlin

### Komiteemitglieder

**Uwe Adler,** SEHO Systems GmbH, Kreuzwertheim

**Dr. Ferdinand Bartels,** Heraeus Precious Metals GmbH & Co. KG, Hanau

**Dr. Udo Bechtloff,** KSG Leiterplatten GmbH, Gornsdorf

**Dr. Hans Bell,** Rehm Thermal Systems GmbH, Blaubeuren

**Dr. Lubomir Cergel,** Genf, Schweiz

**Dr. Farhad Farassat,** F & K Delvotec Bondtechnik GmbH, Ottobrunn

**Prof. Dr. Jörg Franke,** Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

**Dr. Dieter Friedrich,** SMW Elektronik GmbH, Eckental

**Prof. Dr. Elmar Griese,** Universität Siegen

**Klaus Gross,** Fuji Machine Mfg. (Europe) GmbH, Mainz-Kastel

**Norbert Heilmann,** ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG, München

**Jörg Hofmann,** Handke Industriesoftware Entwicklungsgesellschaft mbH, Fürth

**Erik Jung,** Fraunhofer-IZM, Berlin

**Dr. Jan Kostelnik,** Würth Elektronik GmbH & Co. KG, Rot am See

**Prof. Dr. Bernd Michel,** Fraunhofer Institut ENAS, Chemnitz

**Christina Modes,** W.C. Heraeus GmbH, Hanau

**Dr. Nils F. Nissen,** Fraunhofer-IZM, Berlin

**Reinhard Pusch,** RoodMicrotec Stuttgart GmbH, Stuttgart

**Dr. Elisabeth Reese,** VDI/VDE Innovation+Technik GmbH, München

**Prof. Dr. Marcus Reichenberger,** Georg-Simon-Ohm-Hochschule, Nürnberg

**Dr. Franz Riedlberger,** Glonn

**Dirk Schlotter,** Polytec PT GmbH, Waldbronn

**Dr. Jürgen Schrage,** Siemens AG, Paderborn

**Dr. Viktor Tiederle,** RELNETyX AG, Dettingen/Teck

**Dr. Dietrich Tönnies,** Suss MicroTec AG, Garching

**Markos Triantafyllou,** Feldkirchen

**Hans-Günter Ulzhöfer,** SMT Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co. KG, Wertheim

**Prof. Dr. Jürgen Villain,** Hochschule Augsburg

**Dr. Sonja Wege,** Zentrum f. Verbindungstechnik in der Elektronik, Oberpfaffenhofen

**Bolko Wietrzynski,** Diehl BGT Defence GmbH & Co. KG, Überlingen

**Dr. Werner Witte,** BuS Elektronik GmbH & Co. KG, Riesa

**Prof. C. P. Wong,** Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA

**Prof. Dr. Thomas Zerna,** Technische Universität Dresden

## Termine/Einreichung

### Termine

|  |            |
|--|------------|
| <b>Deadline Einreichung</b>                  | 14.10.2012 |
| <b>Komiteesitzung (Auswahl der Beiträge)</b> | 28.11.2012 |
| <b>Termin druckfertige Dokumentationen</b>   | 03.03.2013 |

### Einreichung

Bitte reichen Sie Ihr Abstract online unter [www.smt-exhibition.com](http://www.smt-exhibition.com) im Bereich Kongress/Call for Tutorials ein.

### Sprache

Deutsch oder Englisch

### Inhalt

Titel, Referent(en), Themenzuordnung, Kurzbeschreibung, Kurzbiographie des/der Referenten

### Einzelbeiträge

Einzelbeiträge werden in Ausnahmefällen berücksichtigt. Bei der Einreichung von Einzelbeiträgen erklären Sie sich damit einverstanden, mit anderen Beiträgen zusammengefasst zu werden.

### Auswahl

Das Komitee entscheidet über die Zulassung der Tutorials. Im Anschluss an die Komiteesitzung am 28.11.2012 werden Sie über die Entscheidung informiert.

### Unterstützt von



### Veranstalter

Mesago Messe Frankfurt GmbH  
Rotebühlstraße 83–85, 70178 Stuttgart, Deutschland  
[www.mesago.de](http://www.mesago.de)

### Geschäftsführung

Johann Thoma (Vorsitzender), Petra Haaburger  
Amtsgericht Stuttgart, HRB 13344



### Ansprechpartnerin

Nora Sollfrank, Projektleiterin  
Tel: +49 711 61946-75  
Fax: +49 711 61946-93  
[nora.sollfrank@mesago.com](mailto:nora.sollfrank@mesago.com)

# Einladung

Der Call for Tutorials zur SMT Hybrid Packaging 2013 ist gestartet. Ab jetzt haben Sie wieder die Chance, Ihr Fachwissen auf Europas führender Veranstaltung für Systemintegration in der Mikroelektronik vom 16.–18.04.2013 zu präsentieren.

Das Programm besteht zum einen aus einem hochkarätig besetzten, anwenderorientierten Kongress, in dem brandaktuelle Themen zu verschiedenen Technologien behandelt werden. Zum anderen sind in bewährter Weise Halbtagestutorials vorgesehen, die sowohl Grundlagen- als auch technisches Spezialwissen vermitteln. Der praktische Bezug steht hierbei im Mittelpunkt. Informationen zu aktuellen Trends sowie zum Marktüberblick runden das Programm ab.

## Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit fachkundigen Experten!

Die Beiträge finden bei Fachleuten sowie Entscheidungsträgern aus der Elektronikbranche enorme Beachtung. Werden auch Sie Tutorial-Referent auf der SMT Hybrid Packaging und profitieren Sie vom direkten Austausch über fortschrittliche Technologien, aktuelle Forschungsergebnisse und zukünftige Produktentwicklungen.

## Bahnen Sie erfolgreich neue, hochwertige Kontakte an!

Wir laden Sie ganz herzlich ein, Ihren Beitrag zu den nachfolgend genannten Themen einzureichen.

Berlin, im Juli 2012



Prof. Dr. Klaus-Dieter Lang  
Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und  
Mikrointegration, Berlin  
Vorsitzender des SMT Hybrid Packaging Komitees

# Themen

## Call for Tutorials

1. Aufbau- und Verbindungstechnik
  - 1.1 Lötten
  - 1.2 Kleben
  - 1.3 Bonden
  - 1.4 Drucken
2. Zuverlässigkeit und Qualitätssicherung einer Baugruppe
3. Prozessoptimierung und Traceability
4. Materialentwicklung
5. Bestückung elektronischer Bauelemente
6. Packaging und Systemintegration
7. Leistungselektronik und Hochtemperaturbaugruppen
8. 3-D Integrationstechnologie
9. Entwicklungs- und Konstruktionswerkzeuge
10. Gedruckte Elektronik
11. Fertigungsorganisation und Gesamtanlageneffizienz (OEE)
12. Power LED Systeme und photonische Baugruppen
13. Umwelt, Energieeffizienz, Entsorgung
14. Flexible und starrflexible Baugruppen
15. Panel Level Packaging

## Schwerpunkte Tutorials

- A Produktion und Praxis
- B Forschung und zukünftige Entwicklungen

Bitte ordnen Sie Ihren Tutorial-Beitrag einem der beiden Schwerpunkte zu.

## Referentenstimmen

»Die SMT Hybrid Packaging bietet ein hochaktuelles Forum zu neuen Forschungsergebnissen und innovativen Lösungen.«  
Dr. Markus Sulzberger, Würth Elektronik Flatcomp Systems

»This is a premier conference in the scope of SMT, packaging and hybrid technologies and applications. And I am happy to be a tutorial instructor to a group of keen audience.«  
Dr. Jennie S. Hwang, H-Technologies Group

# Werden Sie Referent!

## Call for Tutorials

Tutorials vermitteln fundiertes, anwendungsbezogenes Wissen über ein spezielles Themengebiet. Praxisbeispiele und gemeinsam erarbeitete Lösungen stehen im Vordergrund. Pro Tutorial stehen drei Stunden zur Verfügung, die von einem oder mehreren Referenten gestaltet werden. Der Tutorialleiter benennt die ihn unterstützenden Referenten. Ideal ist die Beteiligung mehrerer Firmen an einem Tutorial. Zu den Tutorials erhalten die Teilnehmer jeweils eine schriftliche Dokumentation (Script + CD-ROM). Produktvorstellungen und Werbevorträge werden grundsätzlich ausgeschlossen.

## Ihre Vorteile

- **Präsentation** vor einem fachlich hochqualifizierten Publikum
- **Direkter Austausch** über neue Technologien, aktuelle Forschungsergebnisse und zukünftige Produktentwicklungen
- **Netzwerkbildung** mit internationalen Experten aus Industrie und Wissenschaft
- **Einladung zu Messen** sowie Komitee- und Referentenabend
- **Veröffentlichung** Ihres Vortragstitels, Namens und Firma im Kongressprogramm, Kongressflyer und Messekatalog
- **Kostenloser Besuch** der Fachmesse und Vergünstigungen für Kongress und andere Tutorials

